



AU-300 中性半光亮厚纯金

简介：

AU-300 中性半光亮厚纯金是适合各种电镀纯金工艺, 镀层有良好的机械, 物理, 化学性能, 镀液分散能力良好, 镀层半光亮, 孔隙率低, 焊接性能优良。特别适合打金线工艺要求。硬度约 60-80HV, 厚度可达 5 微米以上, 金含量 99.995%, 广泛应用于装饰和电子工业等领域。

设备：

- 镀缸：用 PVC ,PP, 等塑胶制造。
- 整流：波纹系数小于 5 的电源附有安培分钟, 安培计, 电压计及电流调控掣。
- 阳极：不溶性阳极, 如：白金钛网。
- 搅拌：强烈机械式依次环回旋转搅拌, 速率为每分钟 7-14 米。
- 过滤系统：每小时镀液最低过滤四次, 使用高密度滤芯(1-3 微米)。
- 温度控制：使用石英发热笔及恒温器。

镀液配制 (100L 计算)

1. 洗净镀缸后, 加入 50L 开缸剂浓缩液及纯水 40L 及加热至 55 C°
 2. 调整酸碱度至 6.6, 用 KOH 调硷, 磷酸调酸
 3. 强烈搅拌中加入 1KG 氰化金钾溶液,
 4. 以纯水补足水位, 检查各项数据是否在控制范围
- 注：先把氰化金钾溶于热纯水, 再加入镀液中。

操作条件：

	单位	范围	标准
金(纯金计)	克/升	5-10	
电流密度	安培/平方分米	0.2-0.5	0.3
电压	伏特	1.5-1.9	1.8
温度	摄氏(C°)	50-60	55
酸碱度		6.5-7.0	6.6
阴阳极比例		阳极足够	
比重	波美(°Be)	9-11	10
电镀效率沈积	1 μm 1A/d m ²	45C°5g/1 3 分钟	
搅拌		强度机械式	

镀液保养：

金之消耗：大约每 600 安培分钟需补充氰化金钾 50 克，及补充补充剂 50 毫升，保持金含量 5-10 克/升 ± 10%

当生产中镀层色泽暗淡及镀层脆性增大时，需补充光亮剂 5-10 毫升/升（光剂在生产中可与添加补充剂同时补充光剂，补充量约为补充剂 1/10，以保持镀液的稳定性。）

比重：在生产中若比重下降及有效成分减少，补充开缸浓缩液调整，若带水严重，可补充导电盐提高比重。

调酸碱度：在电镀过程中，酸碱度会降低，用 KOH 调整 如酸碱度太高，用磷酸调节，PH 值过高会造成镀层粗糙，PH 值过低影响电流效率，易发红，适时调整。

杂质控制：注意清洗洁净，避免带入有机物或金属杂质，及定期测镀液。

产品目录：

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) AU-300 MAKE UP | (开缸剂) |
| 2) AU-300 REPLENISHER | (补充剂) |
| 3) AU-300 BRIGHTENER | (光亮剂) |
| 4) AU-300 CONDUCTIVITY SALT | (导电盐) |

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。